

# フリップチップボンダ

## FB2000SS Flip chip bonder

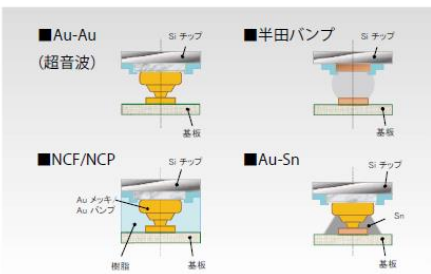
### 半導体の高精度実装に最適なフリップチップボンダ



ヘッド荷重	荷重 30 ~ 2000N
ヘッド種類	超音波ヘッド (ヒータヘッド、マウントヘッドに交換可)
超音波周波数	周波数: 30 kHz/40 kHz/50 kHz から選択
ヘッド制御	荷重、位置、超音波のデジタル制御
アライメント精度	±5 μm
有効ワークエリア	□200mm
接合モニタリング	プロファイル参照ソフト標準搭載
レシビ	接合条件: デジタル設定
ユーティリティ	空圧源 0.5MPa ドライエアー
	電 源 本体 200V50A
ユニットサイズ	W1190 x D1090 x H1650mm (本体部)
ユニット重量	800kg

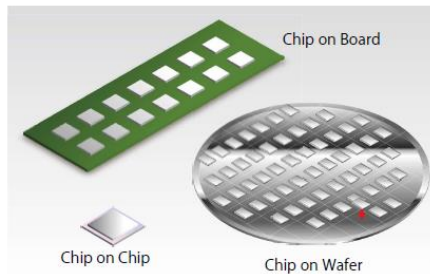
#### アプリケーション

#### ●接合プロセス事例



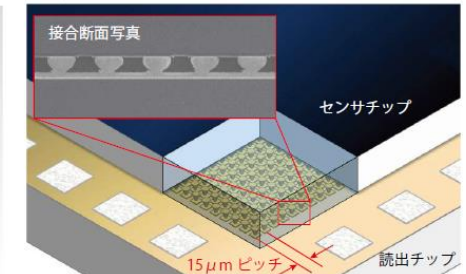
各種接合プロセスに対応

#### ●実装形態事例



ユーザーニーズに合わせてカスタマイズ

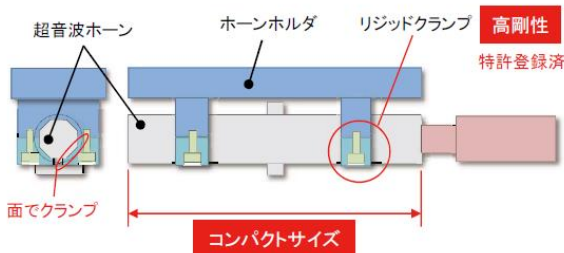
#### ●15 μm ピッチ 30 万バンプ実装事例



15 μm ピッチデバイスを超音波接合

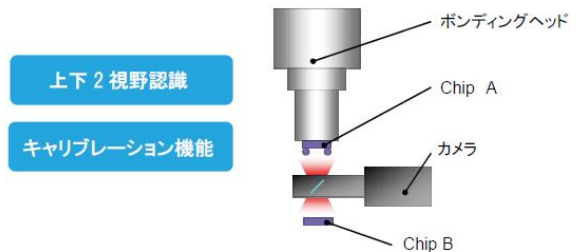
#### 高剛性ホーンクランプ機構

【リジッドクランプ】によって、超音波ホーンをダイレクトにクランプ。高剛性クランプにより高荷重でも高い平面度を確保。



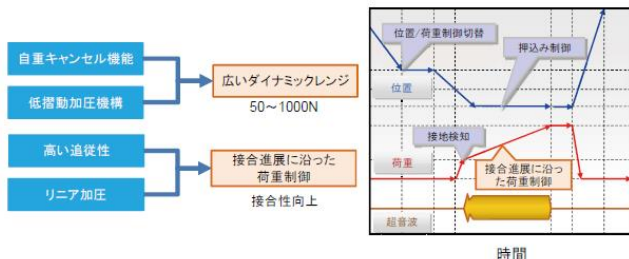
#### 高精度アライメント

上下 2 視野認識に加え、経時変化を補正する【アライメントキャリブレーション機能】を搭載。安定した高精度実装を実現。



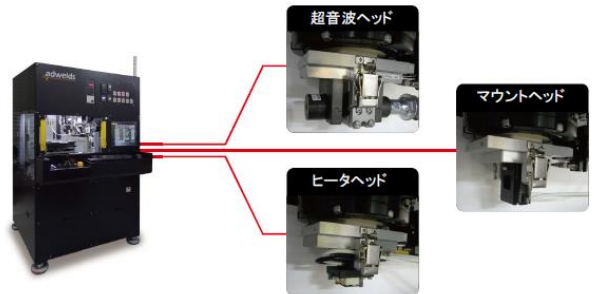
#### 高機能位置荷重制御

低撓動加圧機構による広いダイナミックレンジを実現。接合時の変形に高い追従性を持ち、接合進展と共に荷重を上げるリニア加圧でにより接合性が向上。



#### ヘッド交換で各種プロセスに対応

接合プロセスに合わせて、容易にヘッド交換が可能。御要望にマッチする各種ヘッドをラインナップ。



株式会社アドウェルズ  
福岡 本社  
東京営業所  
名古屋テクニカルセンター

<http://www.adwelds.com> Mail [info@adwelds.com](mailto:info@adwelds.com)  
〒811-1201 福岡県那珂川市片縄 8 丁目 140 番地  
〒140-0004 東京都品川区南品川 5 丁目 10 番 45 号  
〒463-0018 愛知県名古屋守山区桜坂 4 丁目 206 番地

なごやサイエンスパーク 先端技術連携リサーチセンター内

TEL 092-555-6000  
TEL 03-6433-9920